

1. Scope

1. 適用範囲

This specification covers the Mounting Connector on the board and handling of 0.8mm Pitch Faxmodem Socket.
本規格は、0.8ミリ ピッチ ファクス モデム ソケットの取り付け及び取り扱いについて規定するものです。

2. Description

2. 適用製品

Description 名称	Prod. P/N 製品型番
0.8mm Pitch Faxmodem Socket	1123992-1, 1318914-1
0.8mm ピッチ ファクス モデム ソケット	1376545-1

3. Product Features

3. 製品各部の名称

See Fig. 1 for product features.

基本製品構造は Fig. 1の通りです。

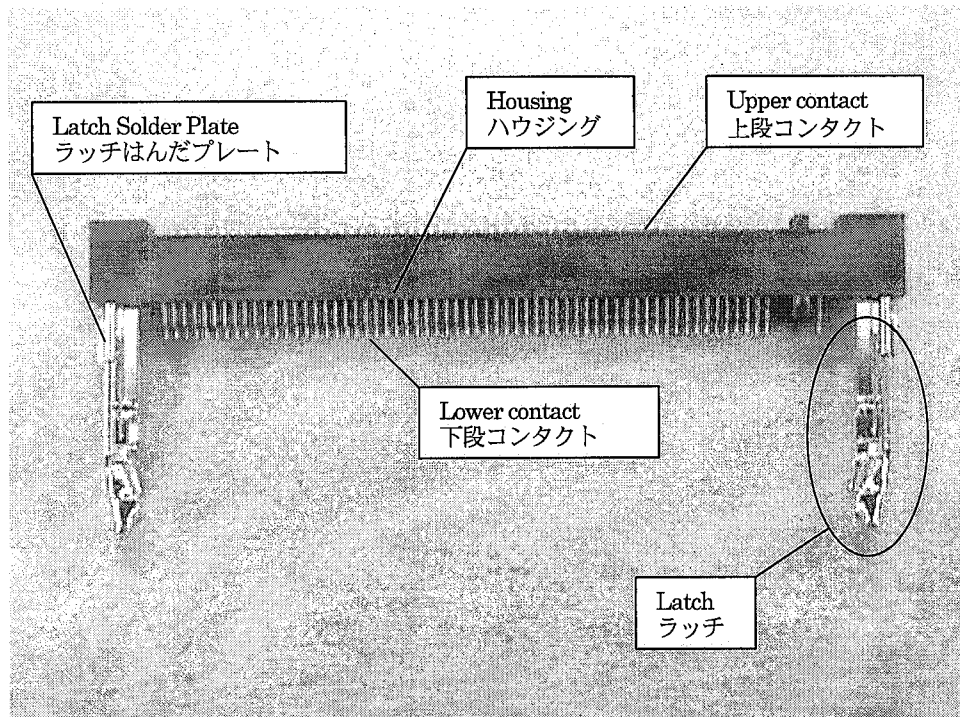


Fig. 1

4. Handling of the connector.

4. コネクタ本体の取扱い

(1) When handling connector, keep fingers away from Latch and Contacttine to avoid deformation. (See Fig. 2) Do not push or add load to avoid the deformation of latch especially in the arrow direction.

(1) コネクタを取り扱う際には、変形防止のため、出来る限り Fig. 2の様にラッチとコンタクトタイン部には触れないようお願い致します。特に図の矢印方向への荷重を加えない様ご注意ください。

Caution : Heavy load on Latch and Contacttine may cause damage to the insertion function of module board, and may result in poor soldering condition.

注意事項：ラッチ、コンタクトタイン部に過度な荷重が加わると、モジュールボードの挿抜機能を損ねたり、はんだ付け不良の原因となります。

(2) Do not put objects such as the tip of screwdriver, or probe of checker etc., inside the contact point.

(2) コンタクト嵌合接触部には、ドライバーの先、チェッカーのプローブ等異物を差し込まないよう御願ひ致します。

Caution : Putting other objects in connector may scrape off Au plating and, may deform the contact.

注意事項：コネクタへ異物を差し込むと、めっきの剥離及び端子変形の原因になります。

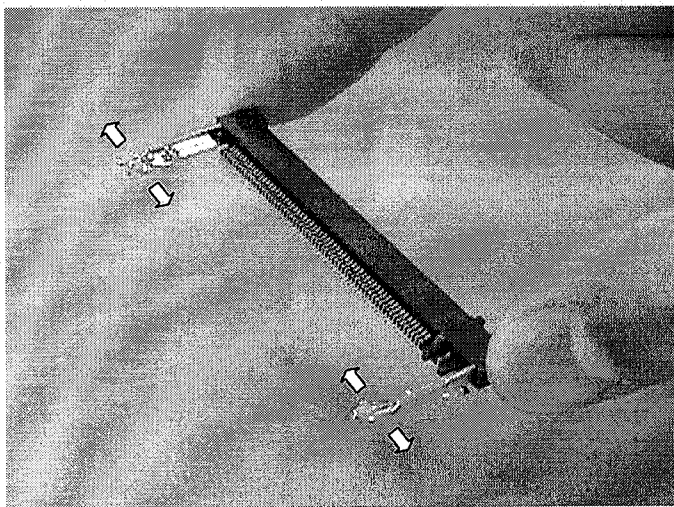


Fig. 2

5. Mounting connector on the board.
5. 基板へのコネクタ取付方法

- (1) Recommended amount of solder
(1) 推奨はんだ使用量

Area of solder : 90 ~ 100% of soldering pattern area.
Thickness of solder : 0.15mm min.
はんだ面積 : 基板パターン面積の90 ~ 100%
はんだ厚 : 0.15mm
を推奨致します。

- (2)-1 When automatic mounting of connector is performed, mounting to regulate and not to deform the latch solder plate and the tine part of the Upper and Lower Contact.
(2)-1 自動実装の場合は、上下段コンタクトタイン部及びラッチはんだプレートに変形を起こさない様、調整下さい。
- (2)-2 When manual mounting of connector is performed, be careful not to deform the latch and the tine part of the Upper and Lower Contact, and mount it parallel to the surface of the board. After mounting, softly push three parts of the connector (See Fig. 3) in order to tighten the grip.
(2)-2 マニュアル実装の場合はコネクタの上下段コンタクトタイン部とラッチを変形させずに保持して、基板面と水平に取付けて下さい。取付け後ははんだ付け性を良好にするため、Fig. 3に示すコネクタの3ヶ所を軽く基板に押し付ける様に押さえて下さい。
- (3) Number of reflow times should be kept twice of less. Reflow is the general method of soldering but in case of using a soldering tool, for fixing purpose, for instance, do not touch the part of Contacts with the tool, in order to avoid deformation.
(3) はんだ付け方法はリフロー法を原則としており、リフロー回数は2回以下であることを推奨致します。尚、はんだ付け部の手直し等によりはんだごてを御使用される際には、変形を防ぐ為に、コンタクトタイン部にこて先を触れないようにご注意下さい。

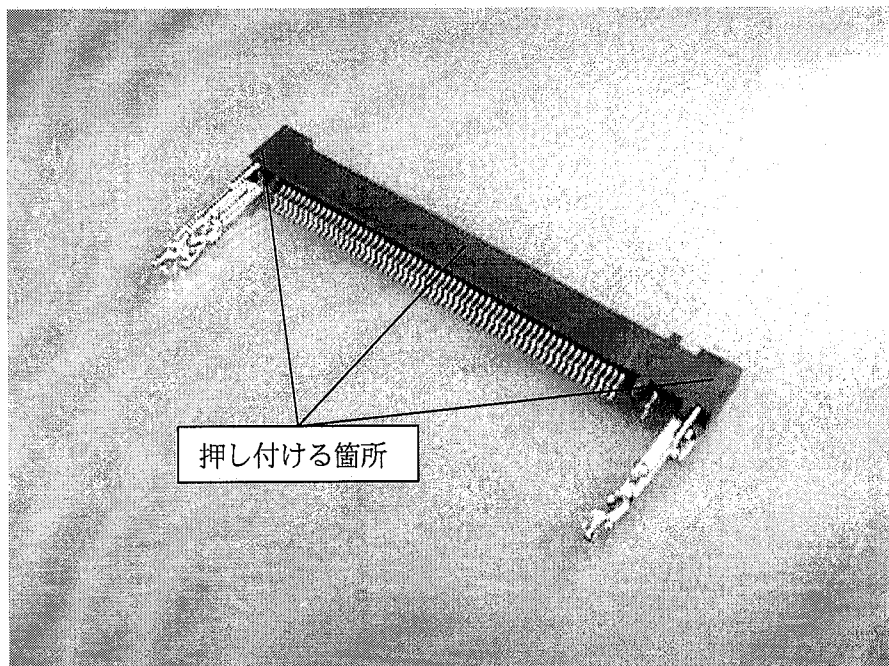


Fig. 3

6. Confirming for soldering condition after mounting.
6. 実装後のはんだ付け状態の確認

- (1) After mounting, check and see if there is a fillet formed at the soldering part of contacttine, as shown in Fig. 4.
(1) 基板実装後、コンタクトタインはんだ付け部に Fig. 4のようなフィレットが形成されていることをご確認ください。

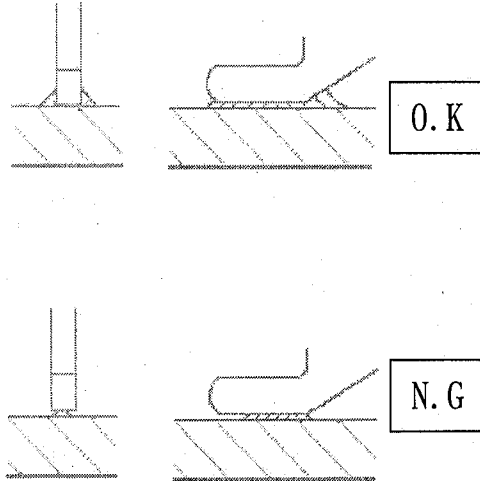


Fig. 4

- (2) After reflow, check and see if there is a fillet formed at the latch solder plate, and make sure that the lever moves in the arrow direction as shown in Fig. 5.
(2) リフロー後、ラッチはんだプレートに Fig. 5の様なフィレットが形成されていて、レバーが矢印の方向へ可動することをご確認ください。

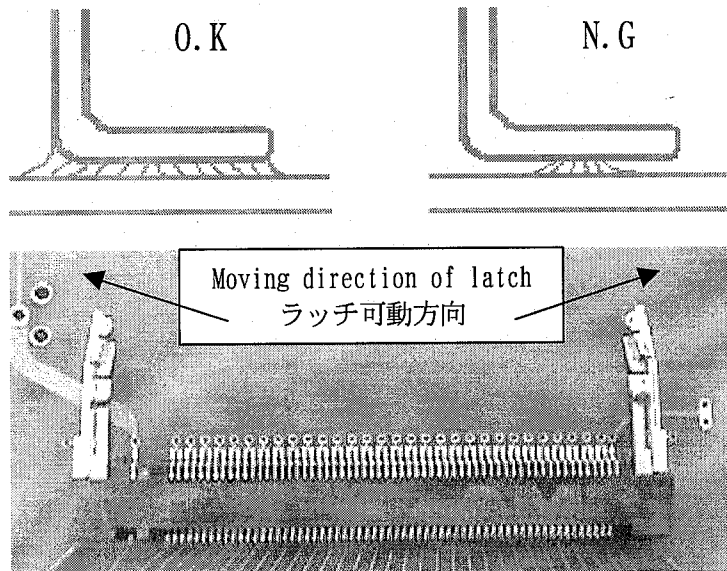


Fig. 5

7. How to use connector.

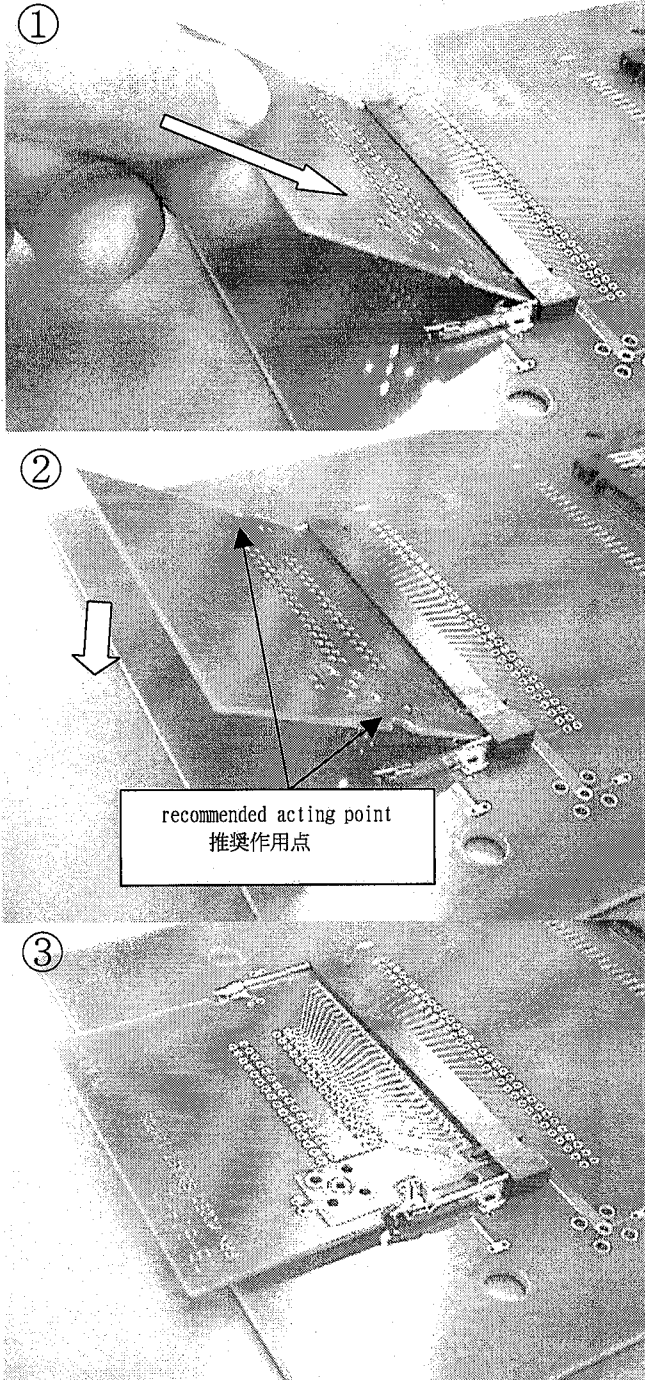
7. コネクタ操作方法

(1) Mounting of the module Board.

(1) モジュールボード取付方法

*As for the module boards to be fitted, use such ones as meeting the requirements of the external dimensions stipulated in our connector drawing C-1123992. If such module boards as not observing the stipulated external dimensions, a trouble of defective performance might be caused in some cases.

*嵌合するモジュールボードは、弊社コネクタ図面 C-1123992 にて規定されている外形寸法が遵守されているものを御使用下さい。規定外のモジュールボードの使用は、不具合発生の原因となる事があります。



1. After confirming that the front and back sides of module boards are correct, insert the module board at an angle of 20~30 deg. into the innermost part of the connector.

1. モジュールボードの表裏が正しいことを確認後、20°~30°の角度でモジュールボードをコネクタの奥まで挿入します。

2. Pushing down the module board downwards, when load is kept applied, the latches at both sides will be turned on.

*If boards having a low rigidity or varied shape are fitted, no latches will be turned on smoothly in some cases. In such a case, placing the action point near the notch of half circle of module board, apply the latches in such a way as pushing against simultaneously at both sides.

2. モジュールボードを下方向に押し倒し、引き続き荷重を加えていくと、左右のラッチが掛かります。

*剛性の低いボードや異形状のボードを嵌合させるとスムーズにラッチが掛からない事がまれにあります。この時は、左図のように作用点をモジュールボードの半円切り欠き部近辺とし、左右同時に押し付けるようにしてラッチを掛けて下さい。

3. If the module board is held by the latches and does not get up, mounting will finish.

3. モジュールボードがラッチに保持され、起き上がってこなければ取付け完了です。

*Be sure to confirm that latches at both sides are turned on correctly. If latches are not applied correctly e.g. half fitting, remove the board in accordance with the next Para. (2)How to remove the module board and refit it once again by starting the fitting procedure with step (1)-1.

*左右のラッチが正確に掛かっていることをご確認下さい。ラッチが半嵌合等で正確に掛かっていない場合は、次項(2)モジュールボード取り外し方法に従い基板を取り外し、再度(1)-1から取り付け直して下さい。

Fig. 6

(2) How to remove the module board.

(2) モジュールボード取り外し方法

① Move both side of Latch simultaneously in the direction shown in Fig. 7, and remove the lock from the board.

① ラッチを、左右同時に Fig. 7 に示すように矢印の方向に動かし、基板から解除します。

Caution : Prevent unnecessary deformation of the latch arms(*1). The deformation of latch cause the lack of the function of product such as the both latches hooks up the module board.

(*1) After the lock is released (displacement of 1mm on point A in the Fig. 7), don't deform the latch arm any more. And don't operate the latch with up to 440gf or higher.

注意事項：ラッチを必要以上に変位させない様をお願い致します(*1)。ラッチが変形すると、ラッチが基板に掛からないといった製品機能を損なう恐れがありますのでご注意ください。

(*1) 基板が解除された (FIG. 7 A 部にて 1mm の変位) 後、更にラッチを変位させないでください。また、440gf 以上の荷重を加えないでください。

② When the lock is released, the board will tilt apporoximately 25 degrees in angle to the connector. The board must be pulled out straight and softly in the angle direction.

② 基板が解除されると、コネクタに対して約 25° の角度で起き上がります。この起き上がっている方向に、基板をこじらずに抜き取ります。

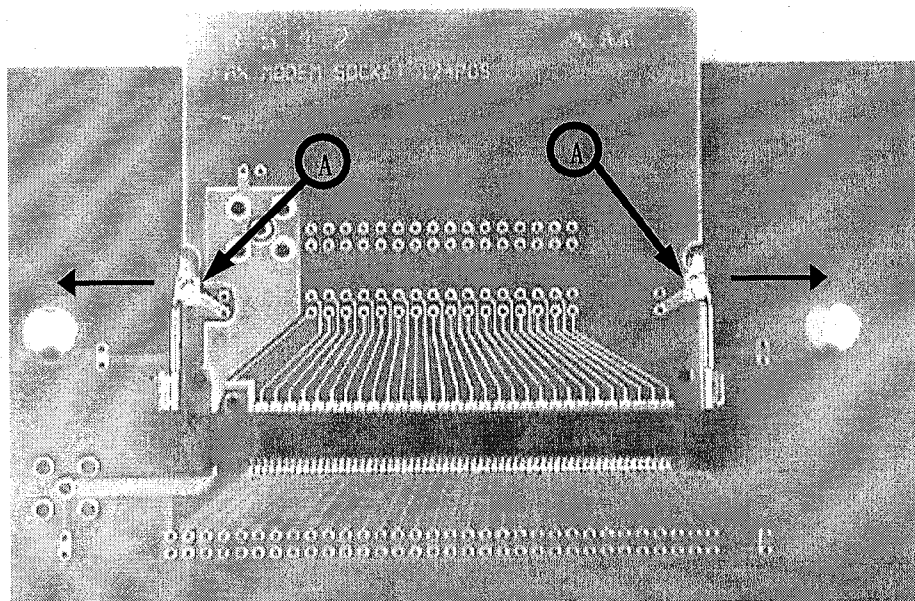


Fig. 7

作成 H. Taguchi
(Prepared by) 田口 季位 H. Taguchi
マルチメディアビジネスユニット
マルチメディア製品技術部
コンピュータ技術部
Product Engineering Dept.
Multimedia Product Engineering Division
Multimedia Business Unit

1/DEC/98
Date

検閲 T. Futatsugi
(Checked by) 二木 卓 T. Futatsugi
マルチメディアビジネスユニット
マルチメディア製品技術部
コンピュータ技術部
Product Engineering Dept.
Multimedia Product Engineering Division
Multimedia Business Unit

1/DEC/98
Date

承認 Y. Yamamoto
(Approved by) 山本 芳久 Y. Yamamoto
マルチメディアビジネスユニット
マルチメディア製品技術部
コンピュータ技術部
Product Engineering Dept.
Multimedia Product Engineering Division
Multimedia Business Unit

1/DEC/98
Date

改訂 LTR	改訂記録 REVISION RECORD	作成 DR	検閲 CHK	承認 APVD	年月日 DATE
0	制定 FJ00-2129-98	H. TAGUCHI	T. FUTATSUGI	Y. YAMAMOTO	1/DEC/98
A	改定 FJ00-2370-98	K. KOBAYASHI	T. FUTATSUGI	Y. YAMAMOTO	25/DEC/98
B	改定 FJ00-0259-98	H. TAGUCHI	T. FUTATSUGI	Y. YAMAMOTO	12/FEB/99
C	改定 FJ00-1318-99	K. KOBAYASHI	Y. YAMAMOTO	Y. YAMAMOTO	27/JUL/99
D	改定 FJ00-1138-00	K. KOBAYASHI	<i>Y. Yamamoto</i>	<i>Y. Yamamoto</i>	4 JULY '00